

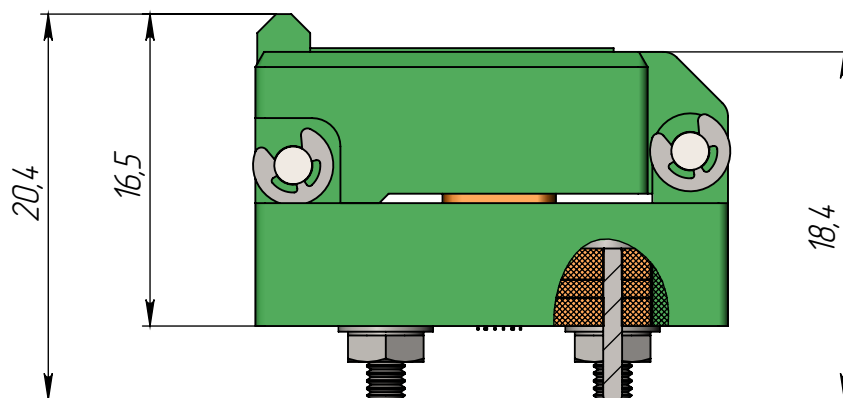
Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Щепанов А.Н.*

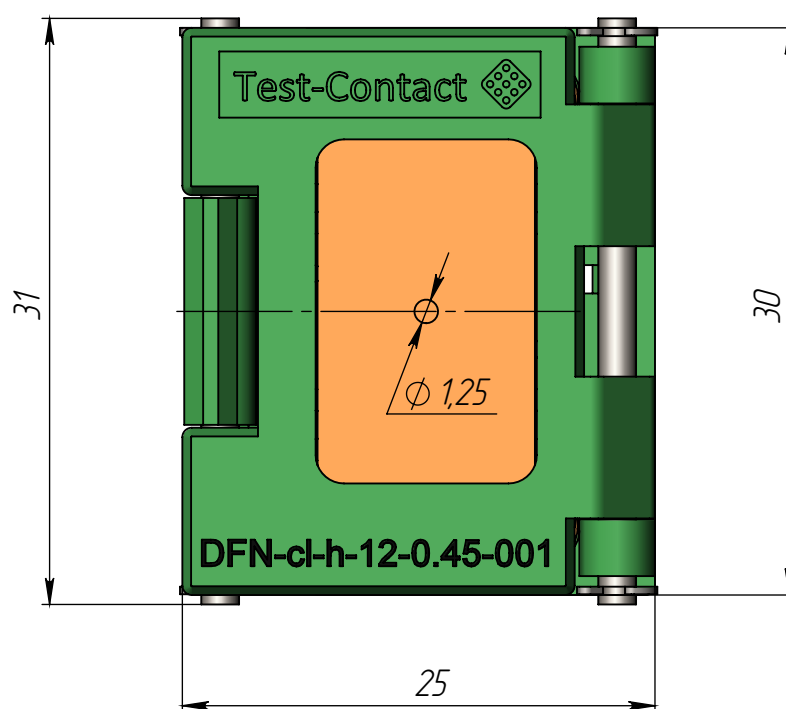
____/____2021г.

____/____2021г.

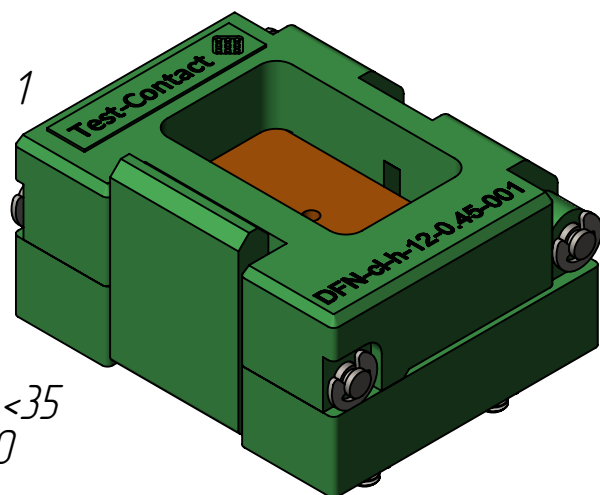
*Паспорт контактирующего устройства
DFN-cl-h-12-0.45-001*



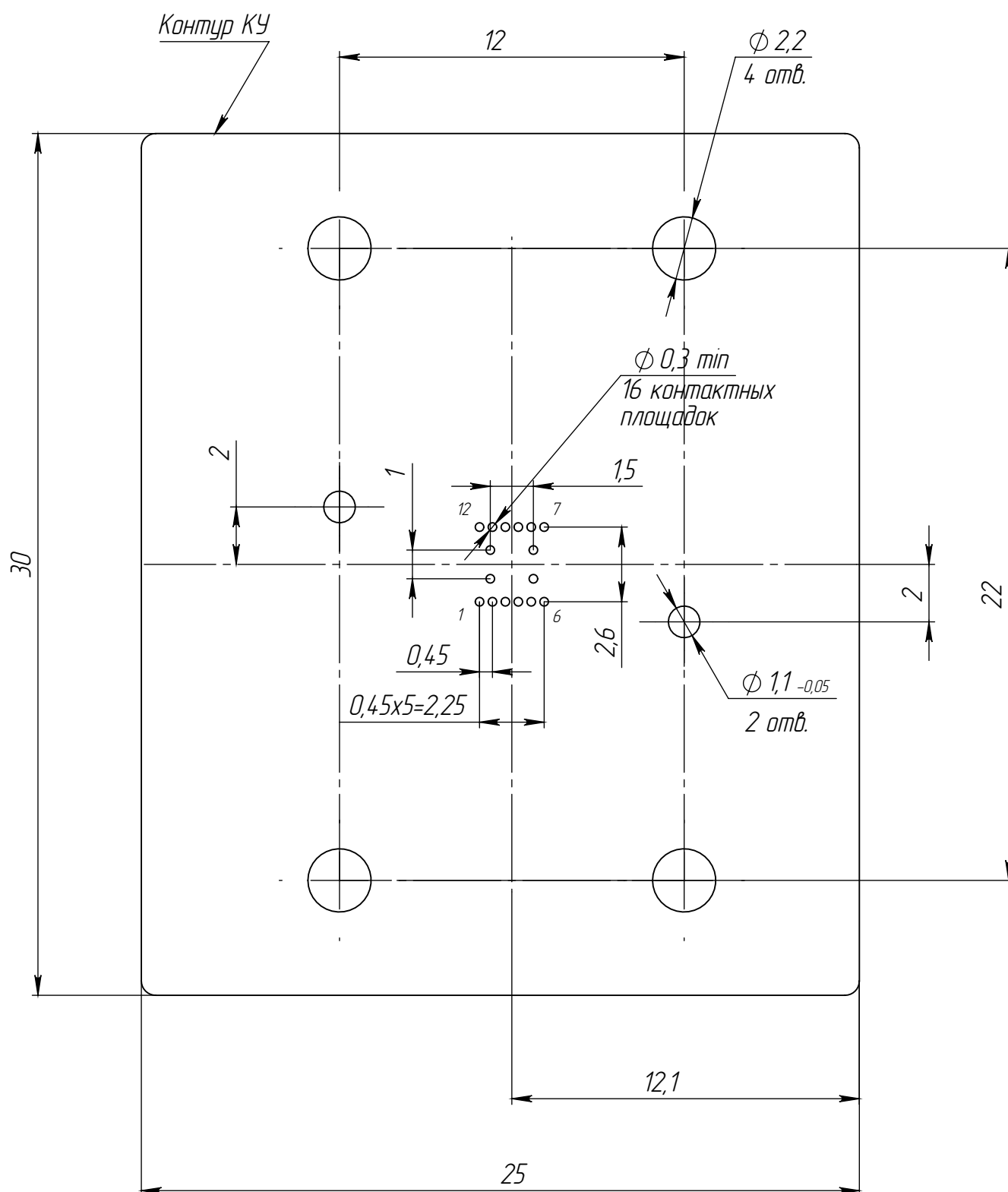
- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.



- × Количество изделий, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 16
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI UL TEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C – -60...+155
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 3,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <35
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1

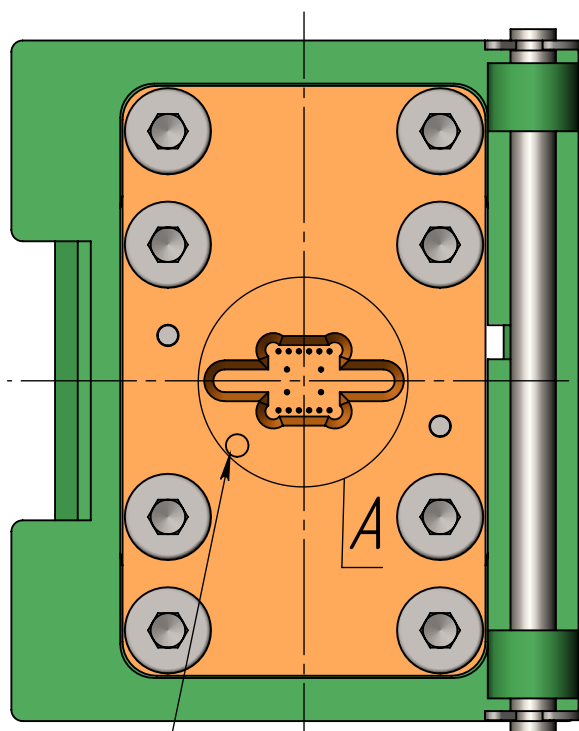
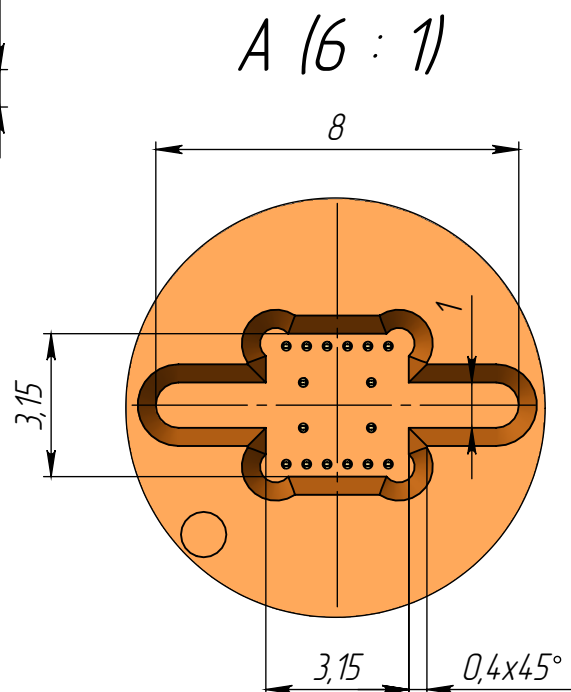
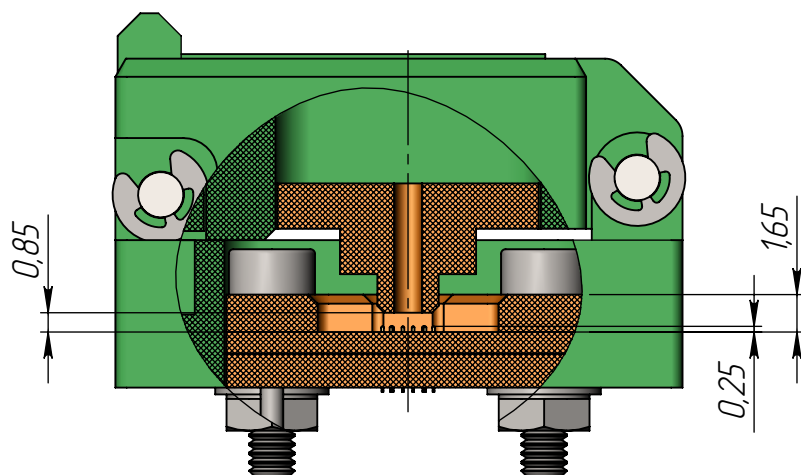


Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху

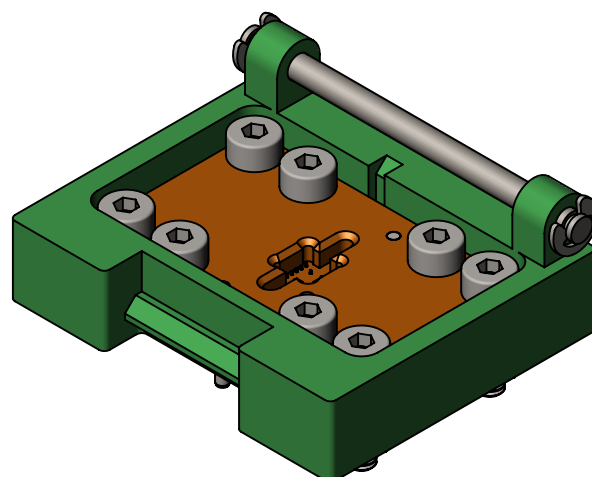
1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-fH.
4. Рекомендованное покрытие контактных площадок – иммерсионное золото. Допустимо – иммерсионное серебро.

Место установки тестируемого изделия

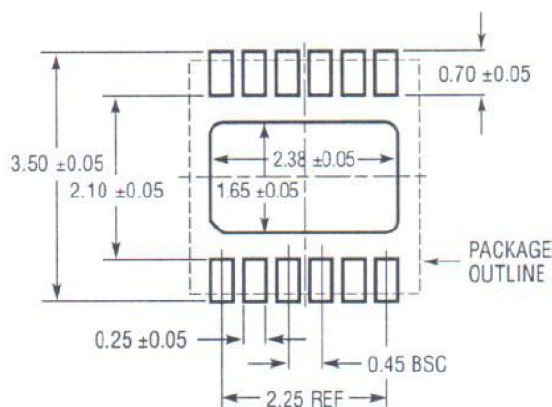


Обозначение
первого вывода

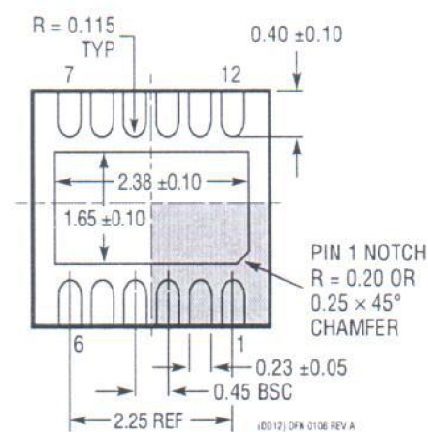
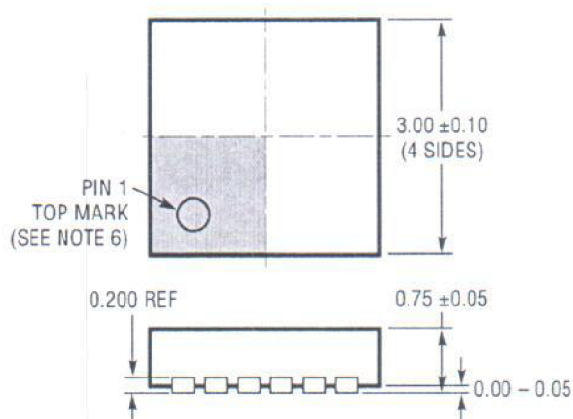
1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фн.



Внешний вид и габариты корпуса изделия (предоставляется заказчиком)



RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS
APPLY SOLDER MASK TO AREAS THAT ARE NOT SOLDERED



BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD

NOTE:

1. DRAWING IS NOT A JEDEC PACKAGE OUTLINE
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. EXPOSED PAD AND TIE BARS SHALL BE SOLDER PLATED
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION ON THE TOP AND BOTTOM OF PACKAGE

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия